



111學年度教師產業研習 半導體封裝製程與 設備實務培訓營

課程簡介

由專家學者與業師共同授課，內容包含半導體封裝製程及設備實務兩個部份。封裝製程主要講授傳統封裝、高階封裝及先進封裝製程等專業知識。設備實務則訓練晶圓切割機、固晶機與打線機的機台操作技能。QFN自動機台操作訓練課程則有機台介紹、製程參數設定及機台運轉測試。

參與對象/報名資訊

高中職及大專院校教師

第二梯次報名時間

112年6月25日截止

報名網址:

<https://forms.gle/4hipgy9nkyBj5VYs5>

名額30位滿額為止

課程時間 / 地點

第一梯次

2023/01/30(一)至2023/02/10(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

第二梯次

2023/07/03(一)至2023/07/14(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

明新科技大學 逢喜樓209室
半導體封裝測試類產線基地



報名QR Code



課程大綱

聯絡人

明新科技大學半導體學院

類產線計畫辦公室

何宗穎助理

TEL : 03-5593142 #3270

合作機構及廠商

教育部產學合作育才平台(台科大辦公室)

工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組

力成科技股份有限公司

廣化科技股份有限公司